

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB</b>	
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Batasan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 Baja .....	4
2.2 Baja AISI 1045 .....	6
2.3 <i>Electroless Plating</i> .....	8
2.4 <i>Electroplating</i> .....	9
2.5 Pelapisan <i>Chrome</i> (Cr).....	11
2.6 Pengujian Ketebalan Lapisan.....	12
2.7 Pengujian Keausan.....	13
2.8 Karakterisasi Menggunakan <i>Scanning Electron Microscopy (SEM)</i> .....	16
2.9 Penelitian Terdahulu .....	17
III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	20
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	21
3.3 Diagram Alir Penelitian .....	26

3.4 Tahapan Penelitian.....	27
3.5 Tahapan Pengujian.....	30
3.6 Pengambilan Data .....	31
IV. HASIL PENELITIAN.....	32
4.1 <i>Electroplating</i> .....	32
4.2 Pengujian Ketebalan Lapisan.....	33
4.3 Pengujian Keausan.....	37
4.4 Karakterisasi Struktur Mikro Lapisan <i>Electroplating</i> Menggunakan SEM – EDX .....	42
V. PEMBAHASAN .....	47
5.1 Pengaruh Tegangan dan Jarak Elektroda Terhadap Ketebalan Lapisan .	47
5.2 Pengaruh Tegangan dan Jarak Elektroda Terhadap Keausan Lapisan ...	49
5.3 Pengaruh Tegangan dan Jarak Elektroda Terhadap Karakterisasi Pada Lapisan Menggunakan SEM – EDX .....	51
VI. KESIMPULAN.....	53
6.1 Kesimpulan .....	53
6.2 Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	